

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2010-207594

(P2010-207594A)

(43) 公開日 平成22年9月24日(2010.9.24)

|                                |                       |             |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| (51) Int.Cl.                   | F I                   | テーマコード (参考) |
| <b>A 6 1 B</b> 8/12 (2006.01)  | A 6 1 B 8/12          | 4 C 6 0 1   |
| <b>H 0 4 R</b> 31/00 (2006.01) | H 0 4 R 31/00 3 3 0   | 5 D 0 1 9   |
| <b>H 0 4 R</b> 17/00 (2006.01) | H 0 4 R 17/00 3 3 2 Y |             |
|                                | H 0 4 R 17/00 3 3 0 J |             |

審査請求 有 請求項の数 3 O L (全 17 頁)

|              |                                     |          |                                           |
|--------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| (21) 出願番号    | 特願2010-106379 (P2010-106379)        | (71) 出願人 | 000000376                                 |
| (22) 出願日     | 平成22年5月6日(2010.5.6)                 |          | オリンパス株式会社                                 |
| (62) 分割の表示   | 特願2005-505240 (P2005-505240)<br>の分割 | (74) 代理人 | 100076233<br>弁理士 伊藤 進                     |
| 原出願日         | 平成16年4月1日(2004.4.1)                 | (72) 発明者 | 沢田 之彦                                     |
| (31) 優先権主張番号 | 特願2003-98213 (P2003-98213)          |          | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目4番2号 オ<br>リンパスメディカルシステムズ株式会社内 |
| (32) 優先日     | 平成15年4月1日(2003.4.1)                 | Fターム(参考) | 4C601 BB02 BB06 BB21 BB22 BB24            |
| (33) 優先権主張国  | 日本国(JP)                             |          | EE10 FE01 GB04 GB05 GB25                  |
| (31) 優先権主張番号 | 特願2003-98214 (P2003-98214)          |          | GB28 GB41                                 |
| (32) 優先日     | 平成15年4月1日(2003.4.1)                 |          | 5D019 AA26 BB20 BB26 FF04 GG02            |
| (33) 優先権主張国  | 日本国(JP)                             |          | GG06 HH01                                 |
| (31) 優先権主張番号 | 特願2003-98215 (P2003-98215)          |          |                                           |
| (32) 優先日     | 平成15年4月1日(2003.4.1)                 |          |                                           |
| (33) 優先権主張国  | 日本国(JP)                             |          |                                           |

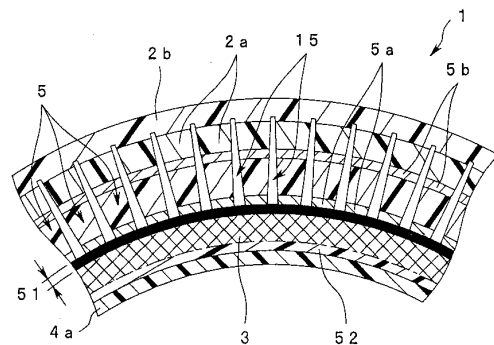
(54) 【発明の名称】 超音波振動子の製造方法

## (57) 【要約】

【課題】各圧電素子に対して均一な音響特性を有するバックリング材を配置して、良好な超音波画像を得られる高信頼性の超音波振動子を提供すること。

【解決手段】第1音響整合層2a上に第1音響整合層2aよりも軟質な第2音響整合層2bを積層して音響整合層2を形成する工程と、両面に電極5a、5bを有する圧電セラミック13を、音響整合層2の第1音響整合層面に積層して積層体22を形成する工程と、圧電セラミック13に所定間隔の分割溝15を形成する工程と、圧電セラミック13が内側となるように積層体22を筒状、または円弧状に変形する工程と、圧電セラミック13側に液状樹脂33を供給する工程と、圧電セラミック13側に中心軸がくるように積層体22を回転させながら、液状樹脂33を硬化させる工程と、を具備している。

【選択図】図16



**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

第 1 音響整合層上に前記第 1 音響整合層よりも軟質な第 2 音響整合層を積層して音響整合層を形成する工程と、

両面に電極を有する圧電体を、前記音響整合層の第 1 音響整合層面に積層して積層体を形成する工程と、

前記圧電体に所定間隔の分割溝を形成する工程と、

前記圧電体が内側となるように前記積層体を筒状、または円弧状に変形する工程と、

前記圧電体側に液状樹脂を供給する工程と、

前記圧電体側に中心軸がくるように前記積層体を回転させながら、前記液状樹脂を硬化させる工程と、

を具備することを特徴とする超音波振動子の製造方法。

**【請求項 2】**

前記超音波振動子は、アレイ型であることを特徴とする請求項 1 に記載の超音波振動子の製造方法。

**【請求項 3】**

前記液状樹脂は、フィラーを含むことを特徴とする請求項 1 に記載の超音波振動子の製造方法。

**【発明の詳細な説明】****【技術分野】****【0001】**

本発明は超音波診断装置等に用いられる超音波振動子の製造方法に関する。

**【背景技術】****【0002】**

医療分野においては、超音波振動子から生体組織に向けて超音波を送信すると共に生体組織から反射される反射波を、超音波を送信した超音波振動子と同一あるいは別体に設けた超音波振動子で受信して信号処理を行って画像化することにより生体組織の情報を得る超音波診断装置が従来より種々提案されている。

**【0003】**

このような超音波診断装置に用いられる超音波振動子として、複数の圧電素子を規則的に配列して順次駆動する電子走査式の超音波振動子がある。このような超音波振動子として、複数の圧電素子を円筒状に配列したラジアルアレイ型、略部分円筒状に配列したコンベックスアレイ型、或いは平板状に配列したリニアアレイ型等がある。

**【0004】**

これらのうち、ラジアルアレイ型の超音波振動子は、例えば、特許文献 1 に記載される超音波プローブに適用される。この超音波振動子は、ダンパー効果のある可撓性を有する薄板で形成された支持部材に、例えばチタン酸ジルコン酸鉛等を素材とした圧電素子板及び音響整合層を順次接着して振動子ユニットを形成する。その後、下層の支持部材を残して長手方向の一辺に直交する所定ピッチの切り溝を切断手段を用いて形成して複数の超音波振動子を有する振動子アレイを構成し、この振動子アレイを構成する支持部材の裏面を断面が円形状の固定部材を兼用したダンパー材（本願の明細書中において「バッキング材」と記載する）の周囲に接着して形成される。

**【0005】**

そして、特許文献 2 には、圧電素子の両面にそれぞれ第 1 の音響整合層及び変形しやすい材料等で形成した背面負荷材を設け、切断手段で所望の間隔で第 1 音響整合層側から背面負荷材の一部に達する切り溝を形成し、所望の曲率に形成した曲面体の外面に背面負荷材を接着固定して超音波探触子を製造する方法が開示されている。

**【0006】**

また、前記アレイ型の超音波振動子については例えば、特許文献 3 の超音波振動子がある。この超音波振動子では、電極を有する圧電体の第 1 面又は第 2 面の少なくとも一方に

10

20

30

40

50

溝又は切り欠きによる凹部を形成し、この凹部に導体を係入配置するとともにこの導体を凹部近傍の電極に電氣的に接続して超音波振動子を形成している。

【 0 0 0 7 】

また、特許文献 4 には、超音波振動子と、この超音波振動子の前面側に設けられた接地電極と、前記超音波振動子の背面側に設けられた正極電極と、前記超音波振動子の接地電極面側に接合された音響整合層と、前記超音波振動子の正極電極側に設けられた背面負荷部材とを重畳させて重畳構造体を形成するとともに、この重畳構造体の片側の側端部において前記前面側の音響整合層から背面側の背面負荷材までの一部を切断除去して接地電極を露出させ、背面負荷材の前記切断面に導体を固着して前記接地電極の端面と電氣的に接続し、また前記正極電極に接続された導体と、を有する超音波探触子が示されている。

10

【 0 0 0 8 】

また、特許文献 5 の電子走査型超音波プローブには振動子ユニットが形成している円筒の中にダンパー材を流し込みラジアル走査型の超音波プローブを構成することが示されている。

【 先行技術文献 】

【 特許文献 】

【 0 0 0 9 】

【 特許文献 1 】 特開平 2 - 2 7 1 8 3 9 号公報

【 特許文献 2 】 特許 2 5 0 2 6 8 5 号公報

【 特許文献 3 】 特開平 1 0 - 3 0 8 9 9 7 号公報

【 特許文献 4 】 特許 2 7 2 9 4 4 2 号公報

【 特許文献 5 】 特開平 2 - 2 7 8 1 4 3 号公報

20

【 発明の概要 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 1 0 】

しかしながら、特許文献 1 の超音波プローブに開示される可撓性の支持部材とダンパー材とを接着剤で固定して形成した超音波振動子では、支持部材とダンパー材との間に設けられる接着層の影響により、パルス幅が延びる等の不具合が発生するおそれがあった。そして、特に、柔らかな部材を接着によって固定した場合には硬質部材同士を接着する場合と異なり、接着層の厚みにばらつきが生じることや、部材形状を高精度にできないこと、接着後の振動子形状精度に不具合が発生して超音波画像の画質が不安定になるおそれがあった。また、ダンパー材や支持部材を曲げて接着固定することによって、これらダンパー材や支持部材に残留応力が加わって信頼性を低下させる要因になっていた。

30

【 0 0 1 1 】

また、特許文献 1 及び特許文献 2 に開示される超音波探触子の製造方法では、可撓性を有する或いは変形しやすい弾性部材を曲げた状態にしてダンパー材或いは曲面体に接着固定することにより所定の形状を形成していた。このため、弾性部材に応力が残留して断線等が発生するおそれがあった。

【 0 0 1 2 】

さらに、弾性を有する柔軟な部材を接着によって固定するとき、硬質部材同士を接着する場合と異なり、接着層の厚みにばらつきが生じたり、部材形状を高精度に形成できないことがあり、所望の形状精度を維持することが難しかった。

40

【 0 0 1 3 】

また、特許文献 3 の超音波振動子では、小さなスペースでグランド配線を確保するために圧電素子に溝を形成することによってマイクロクラック等が発生して素子の信頼性が低下するおそれがあった。一方、小型化するために導体の細線化を図ることによって容量が不足するという問題が発生する。

【 0 0 1 4 】

また、特許文献 4 の超音波探触子では、音響整合層、圧電素子、バックング材等を接合した後に、導電体を露出させるために端面部分を除去していたので、上述の超音波振動子

50

と同様に導電体と圧電素子との間に加わる加工応力が大きく、この部分にマイクロクラック等が発生して素子の信頼性が低下するおそれがあった。

【0015】

また、特許文献5のラジアル走査型の超音波プローブではダンパー材を流し込んで硬化させただけであるので、ダンパー材を形成するために流し込んだこのダンパー材を形成する液状の樹脂部材に混入されている粉体や繊維等のフィラーの分布密度が硬化してダンパー材として形成されたときに不揃いになる。そして、その結果、それぞれの圧電素子に対するバッキング材の特性が不均一になり、複数配置されている圧電素子それぞれの特性にバラツキが生じて、良好な超音波画像を得難くなるという不具合が発生する。

【0016】

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、残留応力の影響を減少させて良好な超音波画像を得ることができる信頼性が高い超音波振動子の製造方法を提供することを目的とする。

【0017】

また、本発明は、さらに、小さなスペースで強固なグランドを確保するとともに、高信頼性とした超音波振動子の製造方法を提供することを目的にしている。

【0018】

さらに、本発明は、各圧電素子に対して均一な音響特性を有するバッキング材を配置して、良好な超音波画像を得られる高信頼性の超音波振動子の製造方法を提供することを目的にしている。

【課題を解決するための手段】

【0019】

本発明の超音波振動子の製造方法は、第1音響整合層上に前記第1音響整合層よりも軟質な第2音響整合層を積層して音響整合層を形成する工程と、両面に電極を有する圧電体を、前記音響整合層の第1音響整合層面に積層して積層体を形成する工程と、前記圧電体に所定間隔の分割溝を形成する工程と、前記圧電体が内側となるように前記積層体を筒状、または円弧状に変形する工程と、前記圧電体側に液状樹脂を供給する工程と、前記圧電体側に中心軸がくるように前記積層体を回転させながら、前記液状樹脂を硬化させる工程と、を具備している。

【発明の効果】

【0020】

本発明によれば、圧電素子に接着剤を使用することなく液状樹脂を配置して、残留応力が発生することが確実に防止することができる。また、液状樹脂が各圧電素子に対して均一に配置されるので、均一な音響特性を有する超音波振動子を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【0021】

【図1】超音波振動子を示す斜視図

【図2A】超音波振動子の構成を説明する長手方向断面図

【図2B】図2Aの矢印Bで示す部分の拡大図

【図2C】図2Aの矢印Bで示した部分の他の構成例を説明する図

【図2D】図2Aの矢印Bで示した部分の他の構成例を説明する図

【図2E】図2Aの矢印Cで示す部分の拡大図

【図3】図2AのA-A線断面図

【図4A】音響整合層を形成する部材を説明する図

【図4B】音響接合層を説明する図

【図5A】第1積層体を形成する部材を説明する図

【図5B】第1積層体を説明する図

【図6A】第2積層体を形成する部材を説明する図

【図6B】第2積層体を説明する図

【図7】基板の導電パターンと圧電セラミックの一面側電極とを電氣的に接続する工程を

10

20

30

40

50

## 説明する図

【図 8 A】分割溝を形成して圧電セラミックを圧電素子に分割している状態を示す図

【図 8 B】切断工程により形成された分割溝を有する第 2 積層体を切断方向から見た側視図

【図 9】複数の圧電素子を設けた第 2 積層体を円筒状に変形させた図

【図 10 A】円筒状の振動子ユニットを形成する部材を説明する図

【図 10 B】第 1 音響整合層に形状形成部材を配置した状態を説明する図

【図 10 C】基板に形状形成部材を配置した状態を説明する図

【図 11 A】コンベックスアレイ型振動子ユニットを形成するための形状形成部材及び第 2 積層体を示す図

【図 11 B】はリニアアレイ型振動子ユニットを形成するための形状形成部材及び第 2 積層体を示す図

【図 12】第 1 音響整合層に設けるグラウンド電極の他の形成方法を説明する図

【図 13】回転状態の円筒状振動子ユニットを説明する図

【図 14】円筒状振動子ユニットの内周面に液状樹脂を供給している状態を説明する図

【図 15】円筒状の超音波振動子の長手方向断面図

【図 16】図 15 の E - E 線断面図

【図 17 A】コンベックスアレイ型振動子ユニットを形成するための形状形成部材及び第 2 積層体を示す図

【図 17 B】コンベックスアレイ型超音波振動子を形成する他の方法を説明する図

【図 17 C】コンベックスアレイ型超音波振動子を形成する別の方法を説明する図

【発明を実施するための形態】

【0022】

本発明を、添付の図面にしたがってより詳細に説明する。

【0023】

図 1 に示すように本実施形態に係る超音波振動子 1 はラジアルアレイ型に構成したものである。超音波振動子 1 は、音響整合層 2、バッキング材 3、円筒状に形成した第 1 の振動子形状形成部材 4 a、第 2 の振動子形状形成部材（以下、形状形成部材と略記する）4 b 及び圧電素子 5 とを有する。音響整合層 2 は、硬質の材料で形成された第 1 音響整合層 2 a と、軟質の材料で形成された第 2 音響整合層 2 b とを積層して形成される。ここで「硬質」とは、予め形成した形状を保つことができる程度の硬さを意味する。一方、「軟質」とは変形などに関して柔軟性を有することを意味する。

【0024】

図 2 A 及び図 3 に示すようにバッキング材 3、圧電素子 5、第 1 音響整合層 2 a 及び第 2 音響整合層 2 b は、超音波振動子 1 の円筒形状の中心から外周側に向けて順に配置される。第 1 の形状形成部材 4 a は音響整合層 2 を構成する第 1 音響整合層 2 a の内方向で、バッキング材 3 及び圧電素子 5 の一端側に隣接するように配置される。圧電素子 5 の他端側には基板 6 が配置される。

【0025】

なお、基板 6 も超音波振動子 1 等の形状に倣い円筒状に形成される。基板 6 としては、例えば 3 次元基板、アルミナ基板、ガラスエポキシ基板、リジッドフレキシブル基板、フレキシブル基板等が用いられる。

【0026】

第 2 の形状形成部材 4 b は基板 6 の内周側で、バッキング材 3 の他端側に隣接するように配置される。また、超音波振動子 1 の第 1 の形状形成部材 4 a が配置される側である一端側には音響整合層 2 が圧電素子 5 よりも長手軸方向に突出するように配置されている。

【0027】

音響整合層 2 は、前述した通り第 1 音響整合層 2 a 及び第 2 音響整合層 2 b で構成されるが、第 1 音響整合層 2 a の材料としては、例えばエポキシ系、シリコン系、ポリイミド系等の樹脂部材に、金属、セラミックス、ガラス等の粉体や繊維を混合したもの、ある

10

20

30

40

50

いはガラス、マシナブルセラミックス・シリコン等が用いられる。一方、第2音響整合層2bの材料としては、例えばシリコン系、エポキシ系・PEEK・ポリイミド・ポリエーテルイミド・ポリサルフォン・ポリエーテルサルフォン・フッ素系樹脂等の樹脂部材やゴム等が用いられる。

【0028】

図1及び図3に示すように第1音響整合層2a及び圧電素子5は所定数、例えば192個に分割されて配列される。

【0029】

パッキング材3としては、例えばアルミナ粉末入りのエポキシ樹脂を硬化させたものが用いられる。なお、パッキング材3として、エポキシ系、シリコン系、ポリイミド系、ポリエーテルイミド、PEEK・ウレタン系・フッ素系等の樹脂部材やクロロブレンゴム・プロピレン系ゴム・ブタジエン系ゴム・ウレタン系ゴム・シリコンゴム・フッ素系ゴム等のゴム材、又はこれら樹脂部材やゴム材にタングステン等の金属、アルミナ・ジルコニア・シリカ・酸化タングステン・圧電セラミックス粉・フェライト等のセラミックス、ガラス、樹脂等の粉体や繊維、中空の粒子などで形成された単一又は複数の物質・形状のファイラを混合したものをを用いても良い。

【0030】

圧電素子5は、板状に形成されたチタン酸ジルコン酸鉛、チタン酸鉛・チタン酸バリウム系・BNT-BST系等の圧電セラミック又は、LiNbO<sub>3</sub>・PZNT等の圧電性結晶・リラクサー強誘電体を切断して形成したものである。一面側電極5a及び他面側電極5bは板状の圧電セラミックの面上に金、銀、銅あるいはニッケル・クロム等の導電部材を焼付け又は蒸着・スパッタ・イオンプレーティング等の薄膜又はメッキ等により、単層・多層又は合金層として予め設けたものである。

【0031】

ここで、図2Aにおける範囲Bの部分拡大図である図2Bないし図2D及び範囲Cの部分拡大図である図2Eに基づき、超音波振動子1における導電系について説明する。

図2Bに示すように圧電素子5の内周側には一面側電極5aが設けられ、外周側には他面側電極5bが設けられている。音響整合層2を構成する第1音響整合層2aの内周側には略全周に亘ってグランド電極8が配置形成される。音響整合層2を構成する第1音響整合層2aの内周側かつ第1の形状形成部材4aの一端には、グランド電極8と接するように導電部7が配置形成される。

なお、グランド電極8の配置については、製造方法の記載と併せて後述する。

【0032】

第1の形状形成部材4aは、第1音響整合層2aの内周面に対して導電部材、例えば導電接着剤（不図示）で接着固定される。これにより導電部7とグランド電極8とが電氣的に導通された状態になる。なお、導電部材は導電接着剤に限定されるものではなく、半田や銀口ウ、金口ウ等の金属口ウ部材、或いは導体被膜等であってもよい。

【0033】

このように、他面側電極5bと、導電部7と、グランド電極8とが電氣的に接続される。

【0034】

図2Bにあっては他面側電極5bと導電部7とが一体的に形成されるが、他面側電極5bと、導電部7と、グランド電極8とは、電氣的に等位となるように接続されれば良い。例えば図2Cに示すように、グランド電極8が音響整合層2の一端側まで連続して設けられるようにしても良い。

【0035】

また、図2Dに示すように、第1の形状形成部材4aの長手軸方向の長さである厚みより少量だけ長く形成して他面側電極5b及び導電部7に長手方向前後の一部分のみが接するように形成しても良い。この場合は、グランド電極8が外側に露出する構成とし、導電部7とグランド電極8との間を、導電性樹脂・導電性塗料等の導体材料や、各種の導体薄

10

20

30

40

50

膜・導体厚膜・メッキ等の導体皮膜で電氣的な導通状態とする。また、これらの材料を組み合わせて用いても良い。

【0036】

図2Eに示すように、圧電素子5と基板6とが隣接する部位の近傍にあっては、基板6の内周側に設けられた導電パターン6aと、一面側電極5aとを電氣的に接続するように、導電部材9がバッキング材3の内周側に配置される。

【0037】

図4Aから図10Cまでを参照して、上述のように構成される超音波振動子1を製造する方法を説明する。

【0038】

超音波振動子1を製造する方法は以下の工程で形成される。

【0039】

(1) 音響整合層2を形成する工程

音響整合層2を形成するために、まず、図4Aに示すように所定寸法及び所定形状で、かつ所定の音響インピーダンス値に調整された第1音響整合層2a及び第2音響整合層2bを用意する。そして、第1音響整合層2aの一面側の所定位置には板状のグランド電極8を配置する。

【0040】

次に、図4Bに示すように第1音響整合層2aと第2音響整合層2bとを一体的に積層して音響整合層2を形成する。このとき、第2音響整合層2bを、グランド電極8が設けられていない第1音響整合層2aの他面側に配置する。音響整合層2は、各々を所定厚さとした後に一体化しても、一体化させた後に所定厚さにしても、接合せずに一方に他方を塗布、注型、成膜等により直接形成しても良く、これらの組合せにより形成しても良い。

【0041】

なお、グランド電極8は、第1音響整合層2aの所定位置に形成した所定幅寸法及び深さ寸法の溝11に、所定幅寸法及び厚み寸法に形成した板状の導電部材12を接着して配置しても良い。また、グランド電極8は、溝11に所定幅寸法で前記深さ寸法より厚めに形成した板状の導電部材を接着して配置しても良い。また、グランド電極8は、図示しない導電樹脂等を突出するように塗布或いは充填した後、この導電部材の突出部分を第1音響整合層2aの面と面一致状態になるように加工して形成しても良い。また、グランド電極8は、所定厚み寸法より厚めに形成した第1音響整合層2aの溝11内に導電部材を接合ないし塗布或いは充填した後、全体を所定厚み寸法になるように加工して形成しても良い。また、グランド電極8は、各種の導体膜で形成しても良い。

【0042】

そして、グランド電極8には、例えば導電性樹脂・導電性塗料・金属等の導体材料や、各種の導体薄膜・導体厚膜・メッキ等の導体皮膜が使用される。

【0043】

(2) 第1積層体を形成する工程

前記第1の工程により形成された音響整合層2と、一面側電極5a及び他面側電極5bを圧電素子の両面に設けた圧電セラミック13とから、第1積層体21を形成する。圧電セラミック13は、音響整合層2の長さ寸法より所定寸法だけ短く形成され、幅寸法は略同一寸法で形成され、厚み寸法は所定寸法に形成される。

【0044】

具体的には、まず、図5Aに示すように音響整合層2及び圧電セラミック13を準備する。

【0045】

次に、図5Bに示すように音響整合層2のグランド電極8が形成された面に、圧電セラミック13の他面側電極5bを、グランド電極8と少なくとも一部が接触するよう、略矩形形状の音響整合層2の一辺から所定量である例えば距離aだけオフセットした位置に接着固定する。

10

20

30

40

50

## 【 0 0 4 6 】

こうして、他面側電極 5 b と圧電セラミック 1 3 のグランド電極 8 とが電氣的導通状態とされた一体的な第 1 積層体 2 1 が形成される。このとき、グランド電極 8 が配置されている音響整合層 2 の一端面側が圧電セラミック 1 3 の一端面側から距離 a だけ突出した状態になる。

## 【 0 0 4 7 】

( 3 ) 第 2 積層体を形成する工程

前述した工程で形成された第 1 積層体 2 1 及び導電パターン 6 a から第 2 積層体 2 2 を形成する。

## 【 0 0 4 8 】

まず、図 6 A に示すように第 2 工程で形成した第 1 積層体 2 1 と、例えば一面側に複数の導電パターン 6 a , ... , 6 a が所定の間隔で規則的に配列された基板 6 とを準備する。この基板の厚み寸法は、圧電セラミック 1 3 の厚み寸法と略同寸法である。

## 【 0 0 4 9 】

次に、図 6 B に示すように導電パターン 6 a , ... , 6 a を上向きにした状態で、基板 6 を圧電セラミック 1 3 に隣接するように配設し、第 1 音響整合層 2 a に対して接着固定する。

## 【 0 0 5 0 】

こうして、第 1 音響整合層 2 a の面上に圧電セラミック 1 3 と基板 6 とが隣接して配置された第 2 積層体 2 2 が形成される。なお、基板 6 の幅寸法及び長さ寸法は所定寸法に設定される。

## 【 0 0 5 1 】

( 4 ) 基板の導電パターン 6 a , ... , 6 a と圧電セラミック 1 3 の一面側電極 5 a とを電氣的に接続する工程

図 7 に示すように第 2 積層体 2 2 の導電パターン 6 a が形成されている基板 6 及び一面側電極 5 a が設けられている圧電セラミック 1 3 の表面の所定位置に図示しないマスク部材を配置し、膜部材である導電性塗料又は導電性接着剤等を塗布したり、金、銀、クロム、二酸化インジウム等の金属や導体を蒸着、スパッタ、イオンプレーティング、CVD等の方法で付着させて、導電膜部 1 4 を設ける。

## 【 0 0 5 2 】

こうして導電膜部 1 4 を形成することにより、導電パターン 6 a , ... , 6 a と一面側電極 5 a とが電氣的に接続される。

## 【 0 0 5 3 】

( 5 ) 圧電セラミック 1 3 を複数の圧電素子 5 , ... , 5 に分割する工程

図 8 A に示すように圧電セラミック 1 3 及び基板 6 の表面側から音響整合層 2 を構成する第 1 音響整合層 2 a を通過させて第 2 音響整合層 2 b の一部に到達する所定深さ寸法で所定幅寸法又は所定形状の分割溝 1 5 を長手方向に対して直交する方向に所定ピッチで形成していく。尚、この分割溝 1 5 は、図示しないダイシングソー又はレーザ装置等の切断手段を用いて形成する。このとき、前記切断手段を 2 つの導電パターン 6 a 、 6 a を分割する中央線上に配置させる。

## 【 0 0 5 4 】

この工程にあっては、複数の導電パターン 6 a , ... , 6 a を設けた基板 6 が、少なくとも 1 つの導電パターン 6 a が配置された複数の基板 6 , ... , 6 に分割されるとともに、圧電セラミック 1 3 も複数個に分割される。このとき、導電膜部 1 4 は複数の導電部材 9 に分割される。このことによって、1 つの音響整合層 2 上に、個々の導電パターン 6 a を導電部材 9 で電氣的に接続した圧電素子 5 , ... , 5 が複数個配列されるようになる。

## 【 0 0 5 5 】

図 8 B に示すように第 2 積層体 2 2 に分割溝 1 5 を所定ピッチで所定個数形成する。このことによって、圧電セラミック 1 3 、基板 6 、導電膜部 1 4 及び第 1 音響整合層 2 a が所定個数に分割されて、圧電セラミック 1 3 及び基板 6 から形成されていた第 2 積層体 2

10

20

30

40

50

2 が、複数の圧電素子 5 , ... , 5 及び複数の基板 6 , ... , 6 を配置した積層体群で形成された第 2 積層体 2 2 a になる。言い換えれば、音響整合層 2 を構成する柔軟性を有する第 2 音響整合層 2 b に、複数の圧電素子 5 , ... , 5 を配列した状態になると言える。

【 0 0 5 6 】

次いで、第 2 音響整合層 2 b が最外周側に配置されるように第 2 積層体 2 2 a を曲げ変形させて、図 9 に示すように第 2 積層体 2 2 a を円筒形状に形成する。

【 0 0 5 7 】

なお、分割溝 1 5 を形成した後、超音波振動子 1 を形成するに当たって不要になる、例えば図 8 A の斜線に示す音響整合層 2 を除去する。また同様に、第 2 積層体 2 2 を構成する各部材について、例えば長さなどについては所定形状よりも大きいものを用い、最終的に不要部分を除去しても良い。さらに必要に応じ、それぞれの圧電素子 5 , ... , 5 の一面側電極 5 a と、基板 6 , ... , 6 の導電パターン 6 a とが導電部材 9 によって電氣的に接続されているかの導通検査を行う。

【 0 0 5 8 】

( 6 ) 円筒状振動子ユニット ( 以下、円筒状ユニットと略記する ) 2 3 を形成する工程  
前述の工程で形成された第 2 積層体 2 2 a と、第 1 及び第 2 の形状形成部材 4 a 、 4 b とから円筒状ユニット 2 3 を形成する。

【 0 0 5 9 】

具体的には、図 1 0 A に示すように第 2 積層体 2 2 a を円筒状に形作った後、図 1 0 B に示すように第 1 の形状形成部材 4 a を音響整合層 2 の第 1 音響整合層 2 a に導電接着剤で一体的に接着固定する。また、図 1 0 C に示すように第 2 の形状形成部材 4 b を圧電素子 5 , ... , 5 に隣設する基板 6 , ... , 6 の内周面側に非導電性の接着剤によって一体的に接着固定する。

【 0 0 6 0 】

こうして、硬質の材料で形成された第 1 音響整合層 2 a と、第 1 の形状形成部材 4 a 及び基板 6 と、第 2 の形状形成部材 4 b とを接着固定することにより、第 2 積層体 2 2 a から所定の曲率の円筒状ユニット 2 3 が形成される。このとき、分割された圧電素子 5 , ... , 5 にそれぞれ設けられている他面側電極 5 b と導通状態となっているグラウンド電極 8 と、第 1 の形状形成部材 4 a の導電部 7 とは一体的に導通状態となる。

【 0 0 6 1 】

導電部 7 には、図示しない超音波観測装置から延出するグラウンド線が接続され、容量が十分に大きいグラウンドが確保される。なお、第 1 の形状形成部材 4 a を第 1 音響整合層 2 a に非導電性接着剤により接着し、その後に導体薄膜、導電性樹脂、導体厚膜等によって電氣的に接続するようにしても良い。

【 0 0 6 2 】

このように、圧電セラミック 1 3 に設けた所定の電極及び形状形成部材の導電部と電氣的に導通状態になるグラウンド電極 8 を音響整合層 2 に予め設け、このグラウンド電極 8 と圧電セラミック 1 3 に設けた所定の電極及び形状形成部材の導電部 7 とを組み立てる工程時に電氣的に接続することによって、各圧電素子 5 , ... , 5 にそれぞれ設けられている他面側電極 5 b を、導電部 7 によって一体になったグラウンド電極 8 に接続して大容量のグラウンドを確保することができる。

【 0 0 6 3 】

なお、本実施形態においては第 1 形状形成部材 4 a 及び第 2 形状形成部材 4 b を用いてラジアルアレイ型の超音波振動子 1 を形成する工程を説明したが、本工程で示した形状形成部材 4 a 、 4 b を使用する代わりに、図 1 1 A に示すように例えば部分円筒形状等に形成した第 3 の形状形成部材 4 c 、第 4 の形状形成部材 4 d を上述と同様に所定形状で所定数に分割された圧電素子 5 , ... , 5 を有する第 2 積層体 2 2 b の第 1 音響整合層 2 a に固定することによってコンベックスアレイ型振動子ユニットが形成するようにしてもよい。

【 0 0 6 4 】

なお、図 1 1 B に示すように、端部が平坦である平板状の形状形成部材 4 e を上述と同

10

20

30

40

50

様に第2積層体22cの第1音響整合層2aに該平坦部が接するように固定すると、リニアアレイ型振動子ユニットが形成される。さらに、形状形成部材の端部形状は円弧や直線に限定されるものではなく、これらの組合せや変形も可能であり、これにより複数個配列されるアレイを自由に配置することができ、よって超音波の走査方向を自在に設定することができる。

#### 【0065】

また、本実施形態においては、グラウンド電極8を、第1音響整合層2aの所定位置に形成した所定幅寸法及び深さ寸法の溝11に、板状の導電部材12を接着配置して構成しているが、図12に示すように、第1の音響整合層2aの所定位置に導電性の材料で構成されるグラウンド膜部24を設けるようにしても良い。具体的には、グラウンド膜部24は、金、銀、銅或いはニッケル・クロム等の導電部材を焼付け又は蒸着等によって形成しても良く、また導電性塗料或いは導電性接着剤等を塗布して形成しても良い。

10

#### 【0066】

このことによって、第1音響整合層2aの所定位置に所定幅寸法及び深さ寸法の溝を形成することなく、第1音響整合層2aの所定位置にグラウンド電極8を設けることができる。

#### 【0067】

(7) バッキング材を形成する工程

バッキング材3は、圧電素子5の一面電極5a側に、フェライト入りゴム材・アルミナ粉入りエポキシ等を材料として用い、接着・注型等の方式により形成することにより前記図1ないし図3に示したような構成のラジアルアレイ型の超音波振動子を形成する。

20

#### 【0068】

以下に、その詳細を説明する。

#### 【0069】

図13に示すように円筒状ユニット23を図示しない治具に載置し、この円筒状ユニット23を曲率の中心を回転軸にして所定速度で例えば矢印に示す方向へ回転させる。この状態で、図14に示すように供給パイプ31を介して、混入装置32で予めエポキシ樹脂にアルミナ粉末を混入してかき混ぜておいた所定の粘性を有する、液状樹脂33を円筒状ユニット23の内周面23aに供給する。次に、円筒状ユニット23を回転した状態のまま液状樹脂33を所定量供給し、その後、所定時間回転状態にして液状樹脂33を硬化させる。なお、円筒状ユニット23の回転方向は矢印に示す方向に限定されるものではなく、逆方向であってもよい。

30

#### 【0070】

こうして、複数の圧電素子5, ..., 5の一面側電極5a側にバッキング材3を設けた、ラジアルアレイ型の超音波振動子1が形成される。

#### 【0071】

このとき、バッキング材3は、液状樹脂33が円筒状振動子ユニット23の回転している状態で硬化して形成されるので、図15に示すように各圧電素子5, ..., 5に対して均一な厚さで、かつ図16に示すように各圧電素子5, ..., 5の一面側電極5aの内周面側から中心方向に向かってアルミナ粉末を均一に分布した状態に形成される。具体的には、一面側電極5aの内周面側から一点鎖線に示す範囲51にアルミナ粉末を高密度に配置して、中心方向に向かうにしたがってアルミナ粉末の密度が徐々に低下して、二点鎖線から中心側にエポキシ樹脂だけのいわゆる上澄み層52を形成したバッキング材3になっている。

40

#### 【0072】

このように、円筒状ユニットを形成し、この円筒状ユニットを所定速度で回転状態にして、硬化させることによってバッキング材となるフィラーを混入した液状の樹脂部材を所定量供給した後、回転状態を保持して供給された樹脂部材を硬化させることによって、各圧電素子の内周面側から中心方向に向かってフィラーが均一に分布して、均一な厚さのバッキング材を形成してラジアルアレイ型の超音波振動子を得ることができる。このことに

50

よって、各圧電素子に対して均一な音響特性を有するバッキング材を配置したラジアルアレイ型の超音波振動子で超音波観察を行うことによって良好なラジアル画像の超音波画像を得られる。

【0073】

なお、圧電素子の一面側電極側に接着剤を使用することなくバッキング材を配置したことによって、バッキング材に残留応力が発生することを確実に防止することができる。

【0074】

また、バッキング材の上澄み層を除去して、超音波振動子の有する内孔の内径を大径に形成することによって、超音波内視鏡を構成する内容物を収容する収容スペースを拡張するようにしてもよい。

【0075】

また、本実施形態においてはラジアルアレイ型の超音波振動子を形成する工程を説明したが、図示は省略するが例えば直径に沿って長手方向に切断して断面形状を例えば略半円状にするなど、所定角度で切断することによってコンベックスアレイ型の超音波振動子を得ることができる。

【0076】

さらに、図17Aに示すように例えば半円形状等に形成した供給パイプ挿通用凹部を設けた形状形成部材4c、4dを上述と同様に所定形状で所定数に分割された圧電素子5、...、5を有する第2積層体22bの第1音響整合層2aに固定してコンベックスアレイ型振動子ユニット22dを形成する。その後、図17Bに示すようにこのコンベックスアレイ型振動子ユニット22dを円筒状ユニット23と略同形状にするダミー部材25を一体的に配置する。そして、その状態で上述と同様に液状樹脂33を供給するとともに硬化させてバッキング材を形成する。その後、ダミー部材25及びバッキング材の不要箇所を除去することにより、前述と同様にコンベックスアレイ型の超音波振動子を得ることができる。

【0077】

また、図17Cに示すようにコンベックスアレイ型振動子ユニット22dを図示しない治具に配置する。そして、この状態で、コンベックスアレイ型振動子ユニット22dを所定の状態で揺動させて液状樹脂33を所定量供給するとともに、所定時間揺動状態にして硬化させることによって、上述の実施形態と同様に各圧電素子に対して均一な音響特性を有するバッキング材を配置したコンベックスアレイ型の超音波振動子を得ることができる。

【0078】

このように、圧電素子から突出している音響整合層を構成する硬質な材料で構成された第1音響整合層に、所定形状に形成した硬質な材料で構成された形状形成部材を固定配置することによって、所定形状の超音波振動子を高精度に形成するとともに、残留応力に起因する不具合の発生を確実に防止した超音波振動子を形成することができる。

【0079】

このことによって、圧電セラミックを複数に分割して形成した圧電素子が高精度に配列されて、高画質の超音波観察像を長期にわたって安定して得ることができる。

【0080】

尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形実施可能である。例えば、本実施形態においては基板6を圧電素子5に併設配置し導電部材により両者を電氣的に接続したが、これに限定されるものではなく、例えばバッキング材の内部又は側面に基板を位置させたり、フレームと基板とを合一すること、基板と圧電素子とを金属細線等で接続しても良い。

【0081】

以上のように、本発明にかかる超音波振動子は、信頼性が高いので、超音波断層画像を得るための超音波観察用等として有用である。

10

20

30

40

50

## 【 0 0 8 2 】

尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形実施可能である。

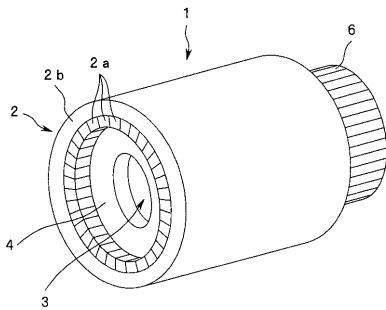
## 【 符号の説明 】

## 【 0 0 8 3 】

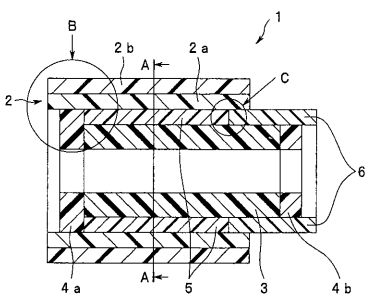
- 1 ... 超音波振動子      2 ... 音響整合層      2 a ... 第 1 音響整合層  
 2 b ... 第 2 音響整合層      3 ... バックリング材      4 a ... 第 1 の振動子形状形成部材  
 4 b ... 第 2 の振動子形状形成部材      5 ... 圧電素子      5 a ... 一面側電極  
 5 b ... 他面側電極      6 ... 基板      6 a ... 導電パターン      7 ... 導電部  
 8 ... グランド電極      9 ... 導電部材      1 1 ... 溝      1 2 ... 導電部材  
 1 3 ... 圧電セラミック      1 4 ... 導電膜部      1 5 ... 分割溝      2 1 ... 第 1 積層体  
 2 2 ... 第 2 積層体      2 3 ... 円筒状振動子ユニット      2 3 a ... 内周面  
 2 4 ... グランド膜部      2 5 ... ダミー部材      3 1 ... 供給パイプ      3 2 ... 混入装置  
 3 3 ... 液状樹脂      5 1 ... 範囲      5 2 ... 上澄み層

10

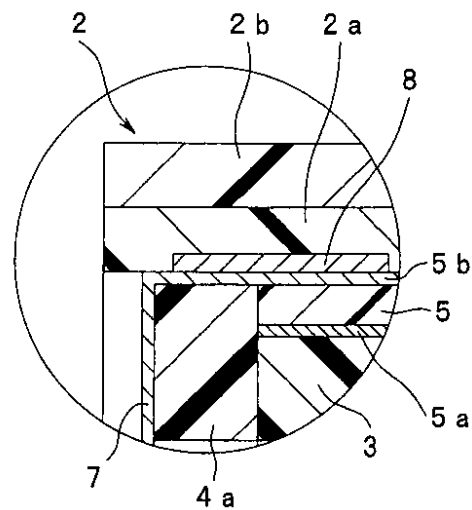
【 図 1 】



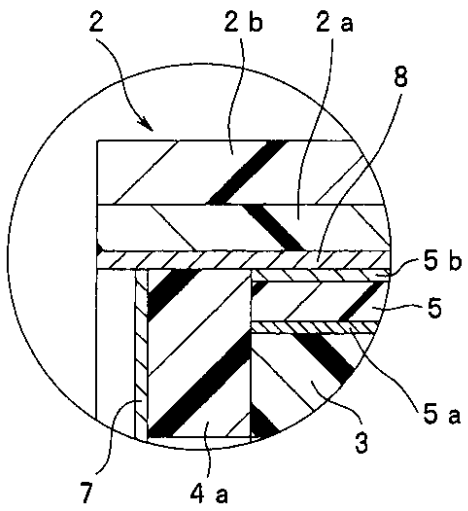
【 図 2 A 】



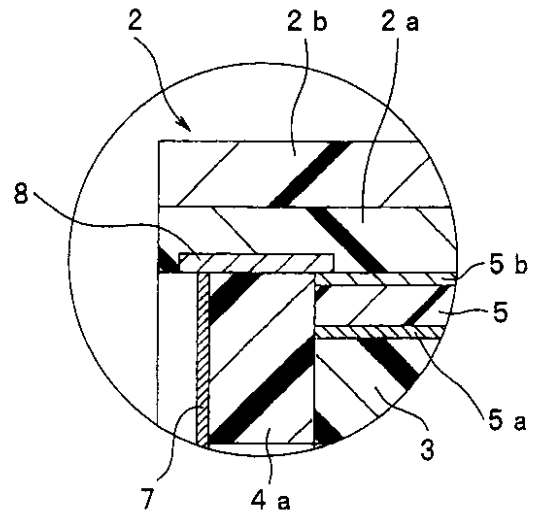
【 図 2 B 】



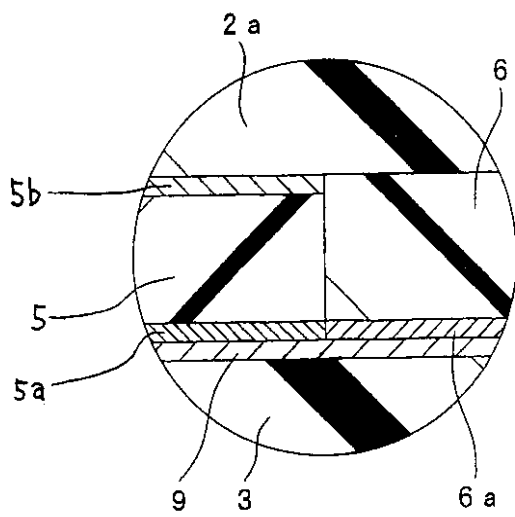
【図 2 C】



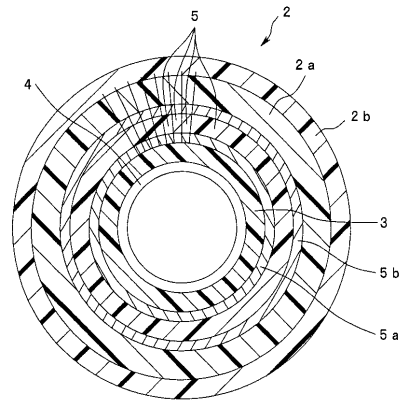
【図 2 D】



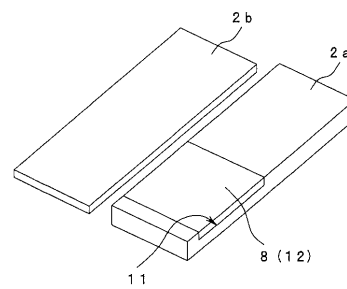
【図 2 E】



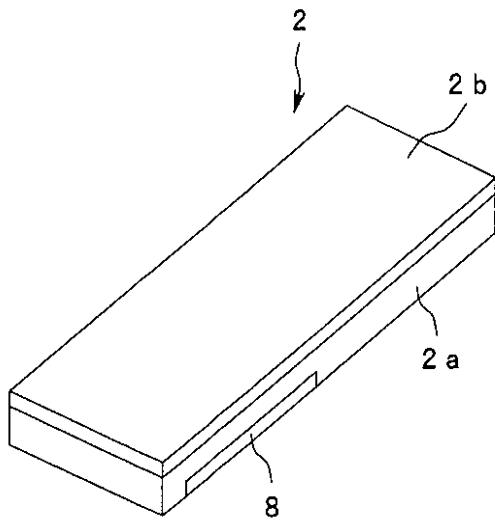
【図 3】



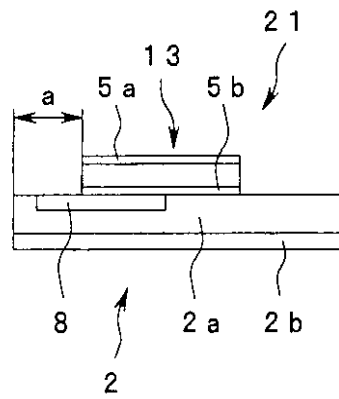
【図 4 A】



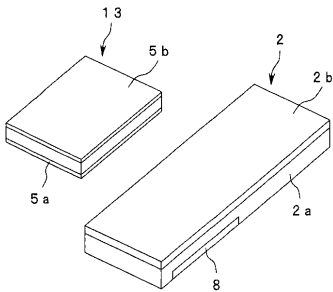
【図 4 B】



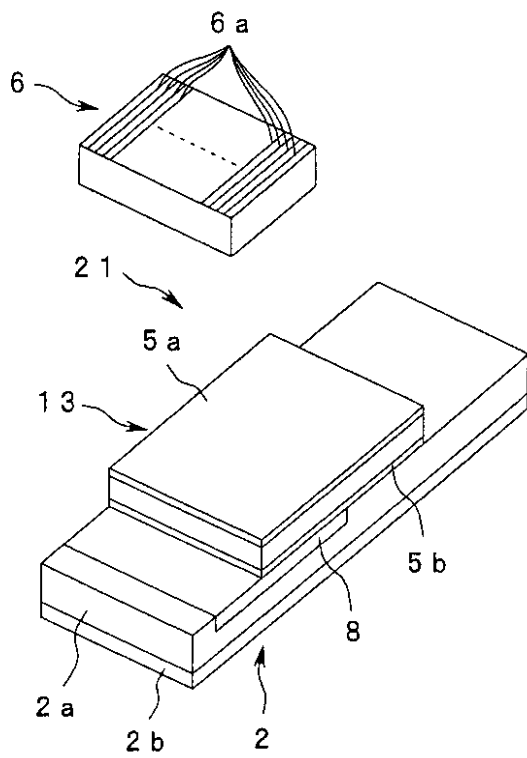
【図 5 B】



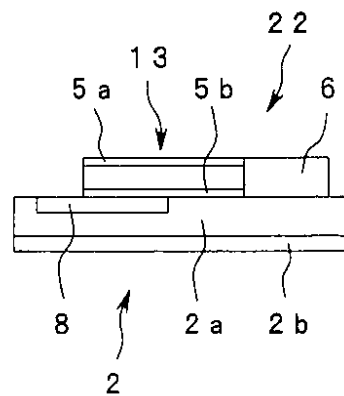
【図 5 A】



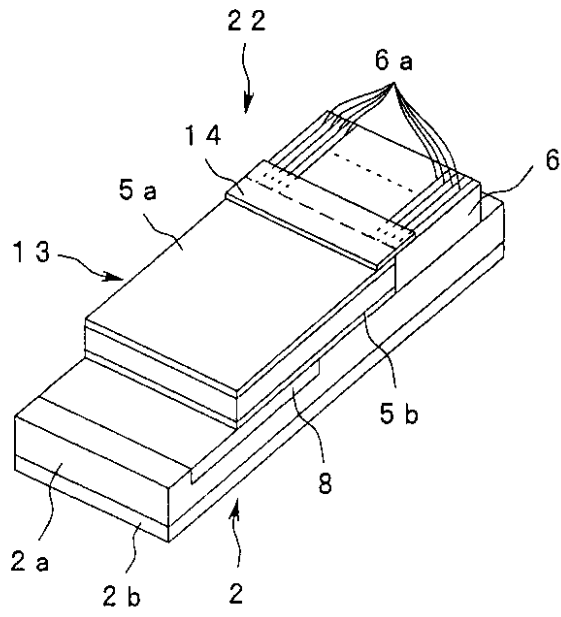
【図 6 A】



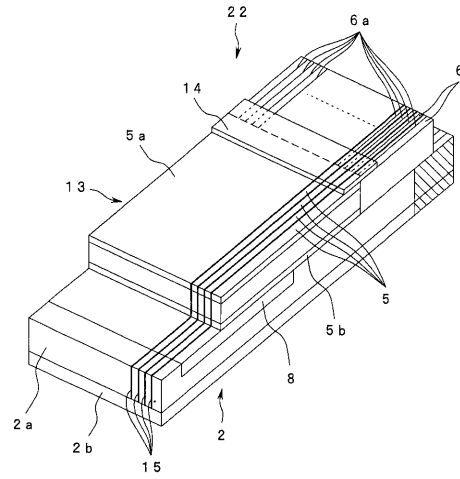
【図 6 B】



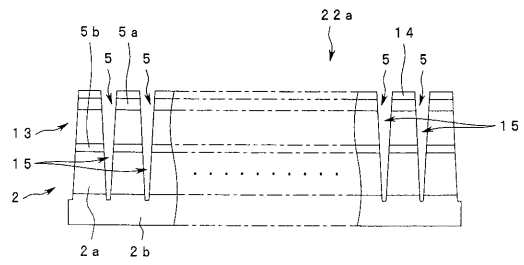
【図 7】



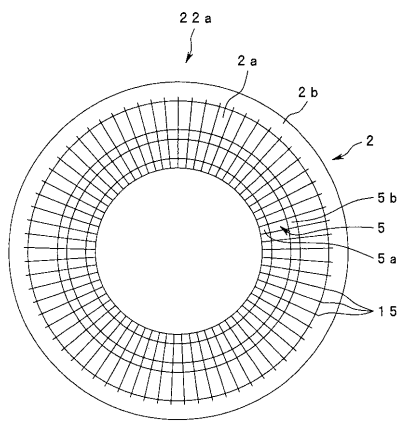
【図 8 A】



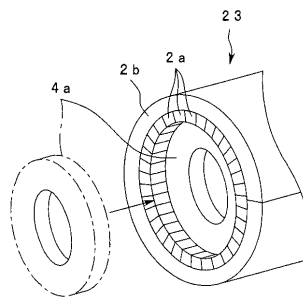
【図 8 B】



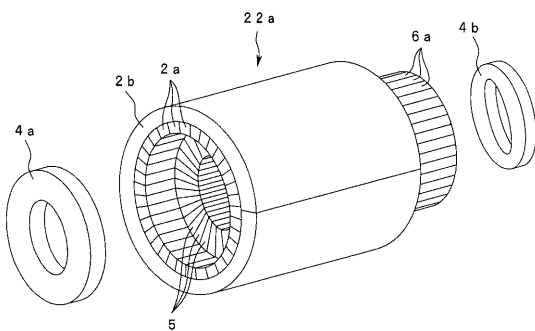
【図 9】



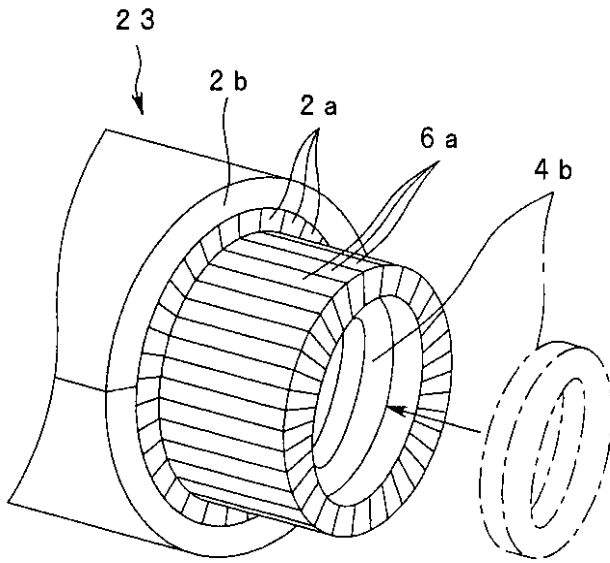
【図 10 B】



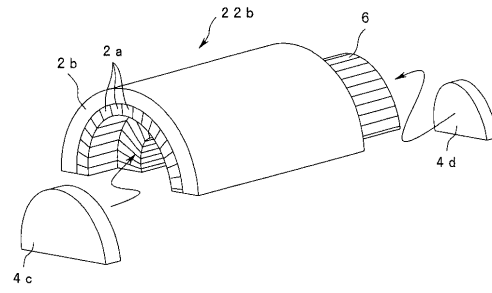
【図 10 A】



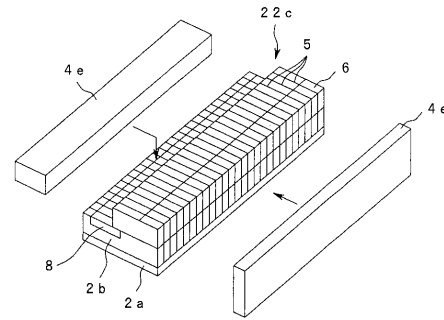
【図 10 C】



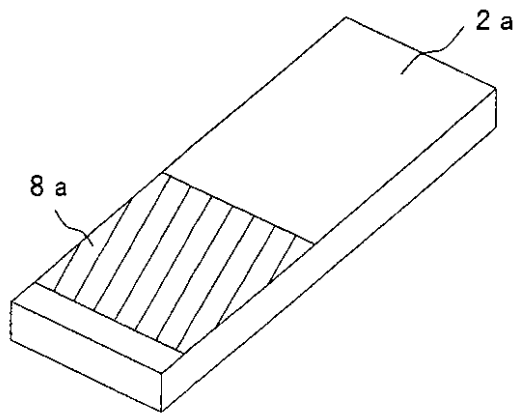
【図 11 A】



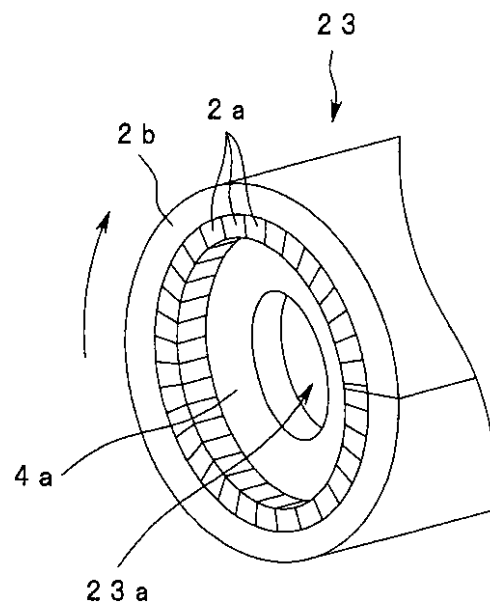
【図 11 B】



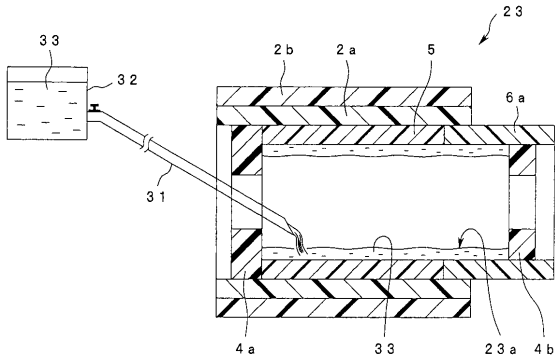
【図 12】



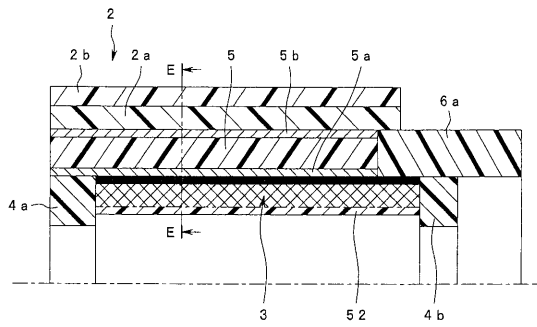
【図 13】



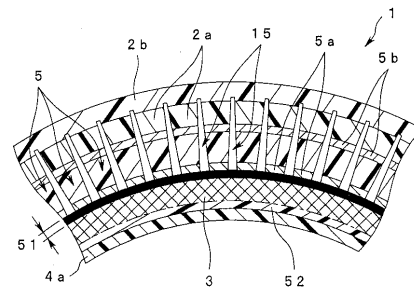
【図 14】



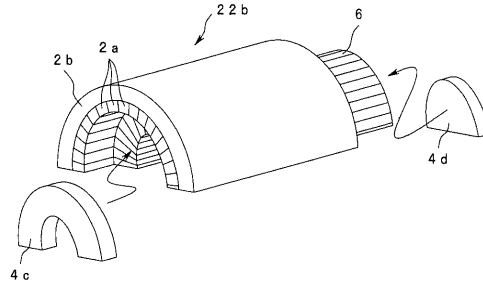
【図 15】



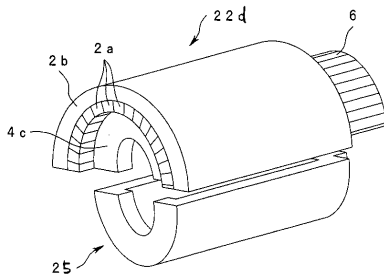
【図 16】



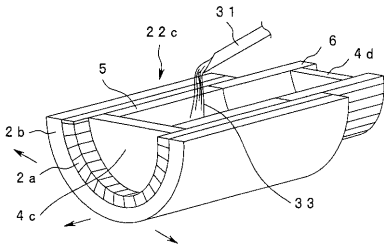
【図 17 A】



【図 17 B】



【図 17 C】



|                |                                                                                                                                                                                                                  |         |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 制造超声波振动器的方法                                                                                                                                                                                                      |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">JP2010207594A</a>                                                                                                                                                                                    | 公开(公告)日 | 2010-09-24 |
| 申请号            | JP2010106379                                                                                                                                                                                                     | 申请日     | 2010-05-06 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 奥林巴斯株式会社                                                                                                                                                                                                         |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | 奥林巴斯公司                                                                                                                                                                                                           |         |            |
| [标]发明人         | 沢田之彦                                                                                                                                                                                                             |         |            |
| 发明人            | 沢田 之彦                                                                                                                                                                                                            |         |            |
| IPC分类号         | A61B8/12 H04R31/00 H04R17/00 B06B1/06                                                                                                                                                                            |         |            |
| CPC分类号         | B06B1/0633                                                                                                                                                                                                       |         |            |
| FI分类号          | A61B8/12 H04R31/00.330 H04R17/00.332.Y H04R17/00.330.J A61B8/14                                                                                                                                                  |         |            |
| F-TERM分类号      | 4C601/BB02 4C601/BB06 4C601/BB21 4C601/BB22 4C601/BB24 4C601/EE10 4C601/FE01 4C601/GB04 4C601/GB05 4C601/GB25 4C601/GB28 4C601/GB41 5D019/AA26 5D019/BB20 5D019/BB26 5D019/FF04 5D019/GG02 5D019/GG06 5D019/HH01 |         |            |
| 代理人(译)         | 伊藤 进                                                                                                                                                                                                             |         |            |
| 优先权            | 2003098213 2003-04-01 JP<br>2003098214 2003-04-01 JP<br>2003098215 2003-04-01 JP                                                                                                                                 |         |            |
| 其他公开文献         | JP5513250B2                                                                                                                                                                                                      |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a>                                                                                                                                                                                        |         |            |

# 摘要(译)

要解决的问题：提供一种高度可靠的超声波振动器，其能够通过将具有均匀声学特性的背衬材料设置到每个压电元件来获得良好的超声波图像。在第一声匹配层2a上层叠比第一声匹配层2a软的第二声匹配层2b以形成声匹配层2的步骤，以及形成在两侧具有电极5a，5b的声匹配层2的步骤将压电陶瓷13层叠在声匹配层2的第一声匹配层的表面上以形成叠层22的步骤，在压电陶瓷13中形成具有预定间隔的分割槽15的步骤，将液态树脂33供给压电陶瓷13侧的步骤；使层叠体22旋转以使中心轴位于压电陶瓷13侧的步骤，以及固化液态树脂33的步骤。 .The 16

